

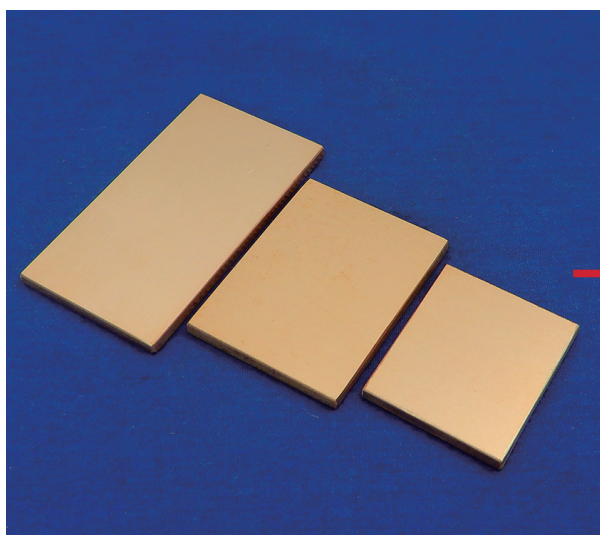


# Application

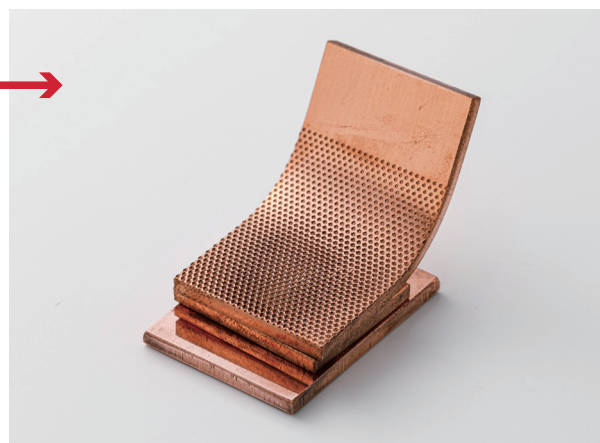
## Bonding ボンディング

### 銅ブロックの積層接合

厚み3mmの3段重ねを溶解なく一括ワンショット拡散接合



Each pure copper plate  
(3mm thick)



#### Point ここがポイント

- 同種金属間の綺麗な接合
- 音のみのエネルギーで接合
- 大気中常温接合
- インゴット接合
- 接合時間約1秒
- サンプルの酸化や溶解ダメージ無し
- 音波ツールやアンビルの発熱がほぼ無し

#### Product used 使用する装置

- 15MZs



AP-J-0103A4-2021082401